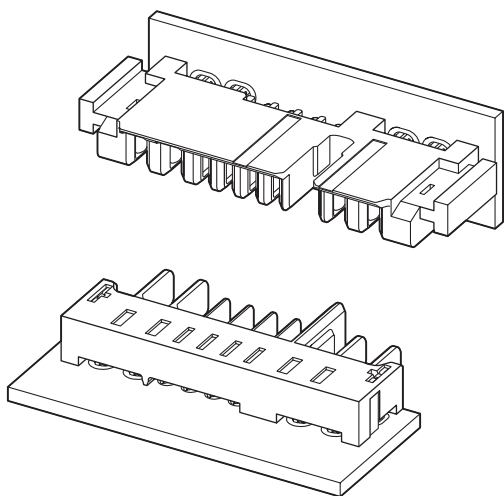




# LBT CONNECTOR B Type

プリント基板用コネクタ/基板対基板用



リチウムポリマーバッテリー接続用、信号極と電源極を明確に分割し、縦・横嵌合時ともに電源極が先に接続されるシーケンス構造を採用。

熱分散構造により、高い通電電流（電源極7A/1極・合計4極）を実現した低背（省スペース）のコネクタです。

- 電源用コネクタ（7A/1極）
- 低背（省スペース）
- 信号極+電源極のハイブリッド仕様
- 熱分散構造
- シーケンス構造（縦・横嵌合時ともに）
- コンタクト露出防止構造

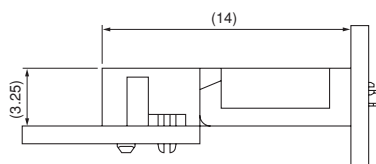
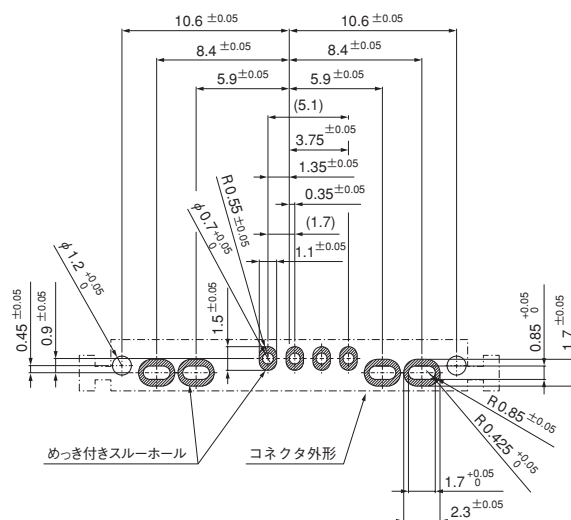
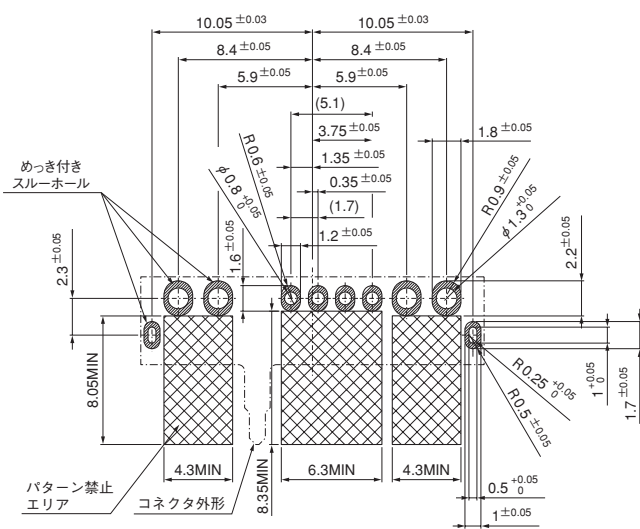
## 登録規格

Recognized E 60389

## 一般仕様

- 定格電流：信号極/0.5A AC・DC  
電源極/7.0A AC・DC
  - 定格電圧：50V AC・DC
  - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
  - 接触抵抗：信号極 初期/20mΩ以下  
環境試験後/40mΩ以下  
電源極 初期/15mΩ以下  
環境試験後/30mΩ以下
  - 絶縁抵抗：100MΩ以上
  - 耐電圧：AC 500V・1分間
  - 適合プリント基板厚さ：1.0mm
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。  
※詳細は弊社までお問い合わせください。  
※RoHS対応品を掲載しています。

## 基板レイアウト・組立レイアウト

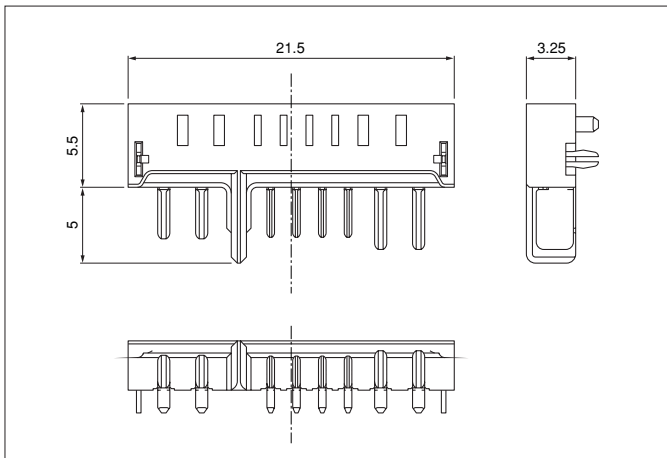


注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。

2) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

# LBT CONNECTOR B Type

## プラグ



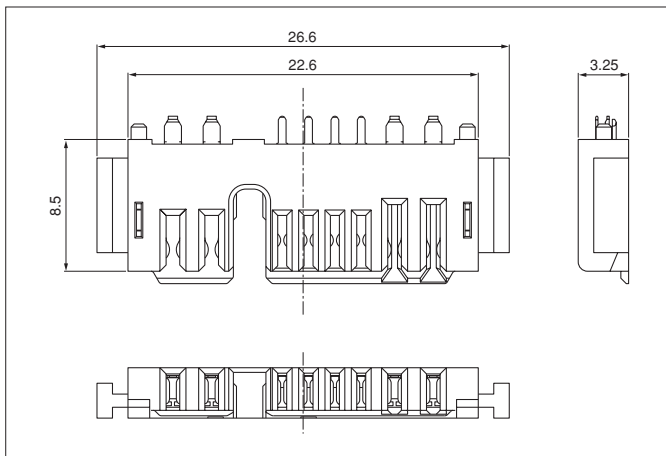
極数		形番	個数/ リール
電源	信号		
4	4	<b>8P-LBTBK-GDDT-4GD-TB(HF)</b>	775

### 材質・表面処理

信号コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき  
はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)  
電源コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき  
はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)  
補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき(リフロー処理)  
ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0

- RoHS対応品
- 上記製品はエンボステープ供給品です。

## リセプタクル



極数		形番	個数/ リール
電源	信号		
4	4	<b>8R-LBTBK-GD-4GD-TB(HF)</b>	1,500

### 材質・表面処理

信号コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき  
はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)  
電源コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき  
はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)  
ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0

- RoHS対応品
- 上記製品はエンボステープ供給品です。

## 形番表示

### プラグ

**8 P - LBTB K - GD DT - 4 GD - TB (HF)**

全極極数

(信号極 + 電源極) : 8

部品名称 : P...プラグ

シリーズ名

色表示 : K...黒

表面処理 (信号極) :

GD...ニッケル下地付 接触部/金めっき

はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)

補強タブ仕様 :

DT...DIP (ヘグピン) タイプ/銅下地付すずめっき(リフロー処理)

電源極極数 : 4

表面処理 (電源極) :

GD...ニッケル下地付 接触部/金めっき

はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)

納入形態 : TB...エンボステープ

ハロゲンフリー表示 : (HF)...ハロゲンフリー

### リセプタクル

**8 R - LBTB K - GD - 4 GD - TB (HF)**

全極極数

(信号極 + 電源極) : 8

部品名称 :

R...リセプタクル (垂直 DIP)

シリーズ名

色表示 : K...黒

表面処理 (信号極) :

GD...ニッケル下地付 接触部/金めっき

はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)

電源極極数 : 4

表面処理 (電源極) :

GD...ニッケル下地付 接触部/金めっき

はんだ付部/すずめっき(リフロー処理)

納入形態 : TB...エンボステープ

ハロゲンフリー表示 : (HF)...ハロゲンフリー